

平成22年3月期 第3四半期決算短信

平成22年2月3日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 リョーサン

コード番号 8140 URL <http://www.ryosan.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 三松 直人

問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役経本部長

(氏名) 関 晴光

TEL 03-3862-2591

四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 —

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年3月期第3四半期の連結業績(平成21年4月1日～平成21年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年3月期第3四半期	140,903	△22.8	3,225	△47.4	3,648	△48.7	1,911	△53.8
21年3月期第3四半期	182,481	—	6,129	—	7,114	—	4,133	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
22年3月期第3四半期	55.47	—
21年3月期第3四半期	117.55	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
22年3月期第3四半期	158,987	116,091	72.9	3,365.00
21年3月期	148,987	116,499	78.1	3,376.78

(参考) 自己資本 22年3月期第3四半期 115,978百万円 21年3月期 116,386百万円

2. 配当の状況

	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
21年3月期	—	40.00	—	40.00	80.00
22年3月期	—	20.00	—	—	—
22年3月期 (予想)	—	—	—	40.00	60.00

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 無

3. 平成22年3月期の連結業績予想(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	185,000	△16.2	4,000	△34.9	4,500	△38.0	2,400	△38.8	69.63

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 無

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの)

- | | |
|-----------------|---|
| ① 会計基準等の改正に伴う変更 | 無 |
| ② ①以外の変更 | 無 |

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	22年3月期第3四半期	34,500,000株	21年3月期	34,500,000株
② 期末自己株式数	22年3月期第3四半期	33,919株	21年3月期	33,358株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間)	22年3月期第3四半期	34,466,285株	21年3月期第3四半期	35,167,463株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の条件に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお業績予想に関する事項は、5ページ「【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1) 全体の概況

当第3四半期連結累計期間(平成21年4月1日～平成21年12月31日)の世界経済は、各国の景気刺激策が功を奏し、リーマンショック以降の急激な景気後退は底を打ったものの、自律的な回復には至らず、総じて厳しい情勢が続きました。また、我々が従事しておりますエレクトロニクス業界は、年央から半導体・電子部品の需給逼迫が深刻になったものの、景気後退前の水準と比較すると、大きく低迷いたしました。

このような情勢下で、当社グループは事業規模の縮小傾向に対しまして、「事業コストの低減」「事業モデルの刷新」に取り組んでまいりました。しかしながら、当第3四半期連結累計期間の業績は、半導体や電子部品の需要が大幅に低下したことから、売上高は1,409億3百万円(前年同期比22.8%減)、営業利益は32億25百万円(前年同期比47.4%減)、経常利益は36億48百万円(前年同期比48.7%減)、四半期純利益は19億11百万円(前年同期比53.8%減)と大幅な減収減益の結果となりました。

(2) 事業の種類別セグメントの業績概況

イ. 半導体事業

当社グループでは、メモリ、システムLSI、個別半導体の販売並びにシステムLSIの開発を行っております。当第3四半期連結累計期間は、デジタルAV機器用及びカーオーディオ用システムLSI等の売上が減少し、売上高は717億76百万円(前年同期比27.5%減)、営業利益は22億29百万円(前年同期比52.5%減)となりました。

ロ. 電子部品事業

当社グループでは、表示デバイス、電源、機構部品を販売しております。当第3四半期連結累計期間は、ゲーム機用電池及びPND用液晶ディスプレイ等の売上が減少し、売上高は457億1百万円(前年同期比25.6%減)、営業利益は16億28百万円(前年同期比36.7%減)となりました。

ハ. 電子機器事業

当社グループでは、システム機器、設備機器を販売しております。当第3四半期連結累計期間は、車載電装用及びMF P用システム機器等の売上が増加し、売上高は200億38百万円(前年同期比21.8%増)、営業利益は5億45百万円(前年同期比44.3%増)となりました。

ニ. 生産事業

当社グループでは、ヒートシンク（半導体素子用放熱器）を生産し、販売しております。当第3四半期連結累計期間は、F A機器用ヒートシンク等の売上が減少し、売上高は33億87百万円（前年同期比39.7%減）、営業利益は3億30百万円（前年同期比38.9%減）となりました。

(3) 所在地別セグメントの業績概況

イ. 日本

当第3四半期連結累計期間は、PND用液晶ディスプレイ及び大型ディスクアレイ装置用システムL S I等の売上が減少し、売上高は1,094億14百万円（前年同期比19.1%減）、営業利益は21億75百万円（前年同期比47.5%減）となりました。

ロ. アジア

当第3四半期連結累計期間は、デジタルA V機器用及びカーオーディオ用システムL S I等の売上が減少し、売上高は379億80百万円（前年同期比32.8%減）、営業利益は7億97百万円（前年同期比49.9%減）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の状況

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて100億円増加し、1,589億87百万円となりました。

また、純資産は、前連結会計年度末に比べ4億7百万円減少して1,160億91百万円となり、自己資本比率は72.9%となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて13億28百万円減少し、486億74百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が35億50百万円であったことに加え、仕入債務が118億10百万円増加した為、売上債権が113億64百万円増加したものの、全体で21億35百万円の資金が増加しました。なお、前年同期の営業活動によるキャッシュ・フローは56億59百万円の資金の増加でした。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得6億15百万円等により5億26百万円の資金が減少しました。なお、前年同期の投資活動によるキャッシュ・フローは33億14百万円の資金の減少でした。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い20億67百万円等により、26億96百万円の資金が減少しました。なお、前年同期の財務活動によるキャッシュ・フローは18億86百万円の資金の減少でした。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

現時点では平成21年10月29日に公表した連結業績予想について、特に変更はありませんが、今後の業績推移を検証の上、適時開示する予定であります。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
該当事項はありません。
- (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続きを採用しております。
- (3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
該当事項はありません。

5. 【四半期連結財務諸表】
 (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	38,676	50,003
受取手形及び売掛金	67,140	56,124
有価証券	9,999	—
商品及び製品	13,042	14,688
仕掛品	108	59
原材料及び貯蔵品	192	191
未収入金	4,290	1,737
未収還付法人税等	25	239
繰延税金資産	238	380
その他	608	630
貸倒引当金	△150	△104
流動資産合計	134,172	123,950
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	4,955	5,131
土地	8,134	8,184
リース資産(純額)	359	463
その他(純額)	969	774
有形固定資産合計	14,418	14,554
無形固定資産	549	628
投資その他の資産		
投資有価証券	3,304	2,890
長期預金	3,500	3,500
繰延税金資産	1,692	2,153
その他	2,532	2,529
貸倒引当金	△1,085	△1,101
投資損失引当金	△98	△118
投資その他の資産合計	9,846	9,853
固定資産合計	24,815	25,036
資産合計	158,987	148,987

(単位：百万円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成21年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	33,397	21,888
短期借入金	4,087	4,773
リース債務	145	157
未払費用	355	1,024
賞与引当金	315	—
未払法人税等	300	109
その他	1,558	1,738
流動負債合計	40,160	29,691
固定負債		
リース債務	294	394
退職給付引当金	2,165	2,086
その他	275	315
固定負債合計	2,735	2,796
負債合計	42,895	32,488
純資産の部		
株主資本		
資本金	17,690	17,690
資本剰余金	19,114	19,114
利益剰余金	81,221	81,443
自己株式	△83	△82
株主資本合計	117,942	118,165
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	327	14
繰延ヘッジ損益	4	3
為替換算調整勘定	△2,296	△1,797
評価・換算差額等合計	△1,964	△1,779
少数株主持分	113	113
純資産合計	116,091	116,499
負債純資産合計	158,987	148,987

(2) 【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日)
売上高	182,481	140,903
売上原価	165,823	128,744
売上総利益	16,657	12,159
販売費及び一般管理費		
荷造運搬費	525	442
貸倒引当金繰入額	—	90
役員報酬	403	313
給料及び手当	2,710	2,367
賞与	1,019	658
退職給付費用	345	323
福利厚生費	601	499
減価償却費	445	623
その他	4,477	3,614
販売費及び一般管理費合計	10,528	8,933
営業利益	6,129	3,225
営業外収益		
受取利息	136	73
受取配当金	337	114
為替差益	198	—
経営指導料	113	87
雑収入	341	248
営業外収益合計	1,127	522
営業外費用		
支払利息	114	32
為替差損	—	51
雑損失	27	15
営業外費用合計	141	99
経常利益	7,114	3,648
特別利益		
固定資産売却益	2	2
投資有価証券売却益	—	12
貸倒引当金戻入額	208	—
投資損失引当金戻入額	13	10
特別利益合計	224	25
特別損失		
固定資産除売却損	33	5
減損損失	—	50
たな卸資産評価損	112	—
投資有価証券売却損	—	14
投資有価証券評価損	225	47
ゴルフ会員権評価損	8	4
特別損失合計	380	122
税金等調整前四半期純利益	6,959	3,550
法人税、住民税及び事業税	2,391	1,272
法人税等調整額	429	363
法人税等合計	2,820	1,636
少数株主利益	4	2
四半期純利益	4,133	1,911

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	6,959	3,550
減価償却費	583	729
減損損失	—	50
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△208	87
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	156	77
受取利息及び受取配当金	△474	△187
支払利息	114	32
投資有価証券評価損益 (△は益)	225	47
有形固定資産除売却損益 (△は益)	33	2
売上債権の増減額 (△は増加)	14,843	△11,364
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△2,236	1,392
仕入債務の増減額 (△は減少)	△9,385	11,810
その他	△1,143	△3,369
小計	9,468	2,861
利息及び配当金の受取額	462	176
利息の支払額	△114	△32
法人税等の支払額又は還付額 (△は支払)	△4,157	△870
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,659	2,135
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△3,000	△1
有形固定資産の取得による支出	△181	△615
有形固定資産の売却による収入	13	4
無形固定資産の取得による支出	△2	—
無形固定資産の売却による収入	—	8
投資有価証券の取得による支出	—	△23
投資有価証券の売却による収入	—	58
関係会社株式の取得による支出	△27	—
貸付けによる支出	△116	△0
貸付金の回収による収入	—	41
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,314	△526
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	2,196	△503
リース債務の返済による支出	—	△122
自己株式の取得による支出	△1,270	△1
自己株式の処分による収入	3	—
配当金の支払額	△2,815	△2,067
少数株主への配当金の支払額	—	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,886	△2,696
現金及び現金同等物に係る換算差額	△542	△248
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△84	△1,336
現金及び現金同等物の期首残高	43,077	50,003
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	8
現金及び現金同等物の四半期末残高	42,992	48,674

(4) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報]

前第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)

(単位:百万円)

	半導体 事業	電子部品 事業	電子機器 事業	生産事業	計	消去又 は全社	連 結
売上高及び営業損益							
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	98,993	61,412	16,455	5,620	182,481	—	182,481
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	98,993	61,412	16,455	5,620	182,481	—	182,481
営 業 利 益	4,693	2,571	378	541	8,184	(2,055)	6,129

- (注) 1. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品・製品の名称
- (1) 事業区分の方法は、事業体制(組織)を基本とし、取扱商品、製品区分並びに販売形態等を勘案し、区分しております。
- (2) 各事業区分の主要な商品・製品の名称
- 半導体事業 …… メモリ・システムLSI・個別半導体
 - 電子部品事業 …… 表示デバイス・電源・機構部品
 - 電子機器事業 …… システム機器・設備機器
 - 生産事業 …… ヒートシンク(半導体素子用放熱器)
2. 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)を第1四半期連結累計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。
- その結果、従来の方法によった場合と比較して当第3四半期連結累計期間の営業利益が「半導体事業」で15百万円、「電子部品事業」で5百万円及び「生産事業」で4百万円それぞれ減少しております。また、「電子機器事業」では3百万円増加しております。

当第3四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日)

(単位:百万円)

	半導体 事業	電子部品 事業	電子機器 事業	生産事業	計	消去又 は全社	連 結
売上高及び営業損益							
売 上 高							
(1) 外部顧客に対する売上高	71,776	45,701	20,038	3,387	140,903	—	140,903
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	71,776	45,701	20,038	3,387	140,903	—	140,903
営 業 利 益	2,229	1,628	545	330	4,734	(1,509)	3,225

(注) 1. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品・製品の名称

(1) 事業区分の方法は、事業体制（組織）を基本とし、取扱商品、製品区分並びに販売形態等を勘案し、区分しております。

(2) 各事業区分の主要な商品・製品の名称

半導体事業 …… メモリ・システムLSI・個別半導体

電子部品事業 …… 表示デバイス・電源・機構部品

電子機器事業 …… システム機器・設備機器

生産事業 …… ヒートシンク（半導体素子用放熱器）

[所在地別セグメント情報]

前第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)

(単位:百万円)

	日 本	ア ジ ア	計	消去又 は全社	連 結
売上高及び営業損益					
売 上 高					
(1) 外部顧客に対する売上高	126,226	56,255	182,481	—	182,481
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	9,095	240	9,335	(9,335)	—
計	135,321	56,495	191,816	(9,335)	182,481
営 業 利 益	4,142	1,591	5,733	395	6,129

- (注) 1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。
 2. 各区分に属する主な国又は地域
 アジア …… 香港・シンガポール・台湾・マレーシア等
 3. 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日)を第1四半期連結累計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。
 その結果、従来の方法によった場合と比較して当第3四半期連結累計期間の営業利益が「日本」で19百万円、「アジア」で2百万円それぞれ減少しております。

当第3四半期連結累計期間(自平成21年4月1日至平成21年12月31日)

(単位:百万円)

	日 本	ア ジ ア	計	消去又 は全社	連 結
売上高及び営業損益					
売 上 高					
(1) 外部顧客に対する売上高	103,419	37,484	140,903	—	140,903
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高	5,994	496	6,491	(6,491)	—
計	109,414	37,980	147,395	(6,491)	140,903
営 業 利 益	2,175	797	2,973	252	3,225

- (注) 1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。
 2. 各区分に属する主な国又は地域
 アジア …… 香港・シンガポール・台湾・中国・マレーシア等

〔海外売上高〕

前第3四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日）

（単位：百万円）

	アジア	計
海外売上高	70,665	70,665
連結売上高	—	182,481
連結売上高に占める海外売上高の割合 (%)	38.7	38.7

- （注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。
 2. 各区分に属する主な国又は地域
 アジア …… 香港・韓国・中国・台湾等
 3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高（ただし、連結会社間の内部売上高を除く）であります。

当第3四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年12月31日）

（単位：百万円）

	アジア	計
海外売上高	47,765	47,765
連結売上高	—	140,903
連結売上高に占める海外売上高の割合 (%)	33.9	33.9

- （注）1. 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。
 2. 各区分に属する主な国又は地域
 アジア …… 香港・韓国・中国・台湾等
 3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高（ただし、連結会社間の内部売上高を除く）であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。